

2007年6月12日  
シノバ社

**報道関係者各位**

## **シノバ社と DISCO HI-TEC EUROPE 社、ハイブリッド・ダイシング装置を共同開発**

**～ ディスコのブレード技術とシノバの LASER-MICROJET®技術の融合により  
画期的なハイブリッド・ダイシング・ソリューションを実現 ～**

2007年6月12日 スイス、ローザンヌ、およびドイツ、ミュンヘン発

シノバ(本社:スイス、ローザンヌ、Synova)社は本日、水ジェット誘導レーザ技術を世界に広めるために、半導体ウェハのダイシング、グラインディング、ポリッシングの世界最大手である株式会社ディスコ(本社:東京都大田区、以下ディスコ)の子会社で、ミュンヘンに所在するディスコ・ハイテック・ヨーロッパ社(DISCO HI-TEC EUROPE GmbH)と提携しました。今回の提携により、両社は、シノバが特許を持つ「Laser-Microjet®」技術とディスコの最新のブレード・ダイシング技術を組み合わせ、最新のハイブリッド型ダイシング装置を開発します。これにより、半導体製造業者はシリコンウェハ、およびあらゆる厚みの新素材ウェハにおける高いスループットとダメージを最小に抑えることができます。

シノバ社 CEO ベルノルド・リヒエルツハーゲン博士(Bernold Richerzhagen)は以下のように述べています。「この提携は、シノバ、そしてパッケージング業界全般にとって重要な節目となります。「Laser-Microjet®」によりこれまでのブレード・ダイシングだけでは決して得ることができなかった仕上がりを実現されます。今回は、市場の要求に応じて、両社の最新の技術を組み合わせて新しいダイシング装置を作ることになりました。ディスコの市場における経験力、グローバルサポート、流通網とシノバの技術、プロセス、アプリケーションは互いに補完し合う良い組み合わせです。我々は、21世紀で最高のダイシング・システムの商品化を共にできることに期待しています」

ディスコ・ハイテック・ヨーロッパ社、副社長カール・ハインツ・プリワッサー(Karl Heinz Priewasser)は以下のように述べています。「シノバ社の水ジェット誘導レーザはさまざまな過程において多くの効果を与えます。シノバ社の技術と我々の最新製品を組み合わせることで、お客様は両社が提供できる最高のソリューションを享受できます」

この合意によりディスコのブレード・ソーのみの共同開発において、シノバ社の主技術をディスコの先端システムに組み込むための研究開発をします。両社は共同でハイブリッド装置の製造、マーケティング、および販売活動を行います。この提携は、両社のビジネスと技術を互いに補完すると同時に、独自のダイシング装置の販売、開発活動を妨げないものです。

より小さく、より多くの機能を盛り込んだ最終製品の需要が続く中、IC 製造業者はより小さなパッケージに、より多くの機能を盛り込むことに取組んでいます。そのような背景の中、複数層で構成された新ウェーハ素材は従来のダイシング技術ではもろくて壊れてしまうということが大きな課題となっています。この提携により、ディスコのブレード技術とシノバ社のレーザ・マイクロジェット技術を組み合わせ、製造業者へ従来と次世代の IC チップにおけるダイシング技術で高い歩留まりとスループットを実現する装置を提供します。

半導体パッケージングに加えて、シノバ社の Laser-Microjet®技術は、FPD、太陽電池、医療器具、自動車部品などの先端機器として導入されています。またシノバ社の Laser-Microjet®技術供与のビジネスにより、更に多くのアプリケーションに応用されます。シノバ社は、既にその分野でよく知られ、経験、知識が豊富ないくつかの企業、研究所、大学と提携の交渉中です。これらの提携により最終ユーザは Laser-Microjet®を導入することによる利益が得られます。

#### Laser-Microjet®の背景

Synova のレーザ・マイクロジェット技術は、髪の毛ほどの水ジェットの界面での全反射現象を利用してレーザービームを材料に当てる技術です。この水ジェットは、レーザ光の発散がなく圧力が極めて小さいので、多孔質、層状物質を問わず材料に変形を起こさせることなく、高精度、微細な加工が可能です。また標準的なダイシングと比べて材料は水によって冷却され、熱による材料の変質を最小限に抑えることが出来ます。同時に加工表面が水に覆われるので除去物による汚染がなく、清浄な加工表面が得られます。これらの効果で、通常のダイシングに比べてデバイスの歩留まりが飛躍的に高くなります。

#### 株式会社ディスコについて

ディスコは高精度の切断、研削、研磨装置の製造、販売会社です。これの装置のトレーニング、販売後のサービス、装置の引き取り、再生、ダイヤモンド砥石の販売も行っています。主要製品は、ダイシング切断機、レーザ切断機、グラインダ、ポリリッシャ、ダイシング・ブレード、グラインディング砥石、ドライポリリッシュ砥石、それら装置の関係部品、ウェーハ用のフレーム、カセットなどです。拠点は、仙台、東京、諏訪、名古屋、大阪、熊本にあり広島に工場があります。海外は、米国、アジア、欧州に拠点があります。15 の子会社と 5 つの関連会社を持っています。詳しくは [www.disco.co.jp](http://www.disco.co.jp) をご覧下さい。

## シノバ社について

1997年に設立されたシノバ社は、半導体、電子、フラットパネルディスプレイ(FPD)及び工業マイクロマシニング産業向けの革新的レーザー技術の大手サプライヤーです。レーザーダイシング技術の発明者として、シノバ社は、その特許技術である「Laser-Microjet® (レーザー誘導式ウォータージェット)」により、今日の最先端電子デバイスの量産に伴う正確な製造仕様と低コスト・オブ・オーナーシップ(CoO)に対応する理想的なプロバイダーとして急速に成長しています。スイスのローザンヌに本社を置くシノバ社は、香港、韓国、日本、および米国に子会社を持つ非上場企業です。その他の情報については、[www.synova.ch](http://www.synova.ch)をご覧ください。

※Laser-Microjet®は、シノバ社の登録商標です。

## お問い合わせ先:

Synova SA  
アルノ・ブルレ

Tel: +41-21-694-3500

Fax: +41-21-694-3501

Email: [brule@synova.ch](mailto:brule@synova.ch)

シノバ・ジャパン(有)

神月 靖

Tel: 0422-55-3811

Fax: 0258-22-3669

Email: [kozuki@synova-asia.com](mailto:kozuki@synova-asia.com)

広報代理: オグルヴィ PR

藤原 亜希子、齊藤 真帆

Tel: 03-5793-2341/2374

Fax: 03-5793-2381

Email: [akiko.fujiwara@ogilvy.com](mailto:akiko.fujiwara@ogilvy.com)